

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

(记录表编号：2025-0601)

投资者关系 活动类别	☐ 业绩说明会 ☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 路演活动 ☒ 分析师会议 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 一对一沟通 ☐ 其他
时间	2025 年 6 月 2 日-6 月 30 日
地点/方式	券商策略会、现场调研
参与单位或 人员（排名 不分先后）	易方达基金、大成基金、财通证券、兴业证券、浩成资管、施罗德投资、国信证券、西部证券、星石投资、融通基金、华西资管、Point 72、信达澳亚、长城基金、中欧基金、国金证券、中银基金、东莞证券。
上市公司 接待人员	董事会秘书：黄恬先生
活动 主要内容	问：公司近期经营情况？产能利用率如何？ 答：公司近期各项业务经营正常，汽车电子、算力硬件等市场的需求保持暖意，产能利用率仍处于相对高位，较 2025 年第一季度有所提升。 问：信丰基地的产能爬坡进展？订单情况？ 答：受益于汽车智驾产品需求旺盛及公司在客户端的供应份额提升，信丰高多层基地的产能爬坡与客户导入进度较快，当前在手订单覆盖产能爬坡需求，公司继续推进技术能力提升、客户认证等工作，未来将随技术认证突破及下游需求放量逐步释放效能。 问：用于 AI 服务器的 PCB 有何特征？是否有新的业务进展？ 答：AI 技术的普及正在带动相关硬件产业飞速发展，已成为 PCB 产业市场规模扩张和技术升级的重要驱动。AI 大算力的相关产品对信号传输的速率、带宽、损耗、散热等方面都提出了新的要求，促使 PCB 持续向大尺寸、高层

数、高密度、高集成、高速/高频、高散热等方向快速迭代升级。公司积极拥抱机遇与挑战，配合客户提出的需求，快速提供解决方案，同客户一起攻关，市场认可度不断提高。

问：北美云厂商对 ASIC 的关注度持续提升，公司是否有进行相应的技术和客户储备？

答：深度学习架构下的 AI 芯片以技术路线可划分为 GPU、ASIC、FPGA 等类别，头部云厂商积极布局不同技术路径，都推动了高端 PCB 市场快速扩容升级。公司持续加码研发创新与产能供给，在珠海基地具备相应技术储备，与服务器厂商及 ODM 客户保持良好的合作关系，不断以高附加值产品为客户创造价值。

问：公司光模块产品的出货情况和利润空间如何？

答：公司已批量生产 10G/25G/100G/200G/400G/800G 光模块产品，完成 1.6T 光模块产品的打样并具备量产能力，前瞻性布局 3.2T 光模块技术预研。高端光模块产品对技术的要求很高，利润和技术是关联的，高端光模块等领域订单批量出货是 2024 年以来珠海金湾基地的盈利能力明显改善的重要原因之一。公司将紧跟客户需求，做好技术储备，提供符合客户需求的解决方案。

问：公司在相控阵雷达业务的布局及后续规划？

答：公司对相控阵雷达相关产品的布局较早，已具备多项专利储备、行业头部客户储备和技术优势。相控阵雷达技术已经在卫星及终端中得到广泛应用，中长期看，伴随我国电子信息产业技术进步和相控阵雷达超高精细化探测能力提升，该技术有望在海洋监测、民用航空、低空经济、公共安全、气象探测、水利测雨等民用领域不断拓展。公司将持续推动客户导入、产品打样、技术能力提升等工作，为更多的下游客户提供兼具高可靠性、卓越性能与成本优势的产品。

问：请简单更新一下公司最近一期股东减持计划的进展？

答：本次减持是股东根据自身资金安排综合考虑的，是资本市场的正常交易行为，不会对公司治理结构及持续经营情况产生影响。截至 2025 年 6 月

	23 日，最近一期股东减持计划中以集中竞价减持部分已实施完毕；剩余额度将以大宗交易的方式完成（股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的时间、数量和价格等存在不确定性），不属于通过二级市场减持，根据证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》有关规定，受让方在受让后 6 个月内不得减持其所受让的股份。 问：公司之后是否有并购重组计划？ 答：公司管理层积极关注产业链的发展趋势及潜在机会，根据公司战略发展的需要，密切关注与公司印制电路板主业相关的合作契机。针对潜在并购机会(如有)，公司将结合自身发展战略与外部环境，审慎评估，并及时履行信息披露义务。 注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件	无
记录时间	2025 年 7 月 1 日整理